



# LD劈開装置 ABK-2000

LDバー化工程において新方式開発 (特許申請中)

順次劈開を実施し工数の削減と不良の低減を

可能にした装置誕生！

## 特徴・機能

- 少ない工数：ワークをセットしアライメントした後は、自動で順次劈開を行いますので、従来必要だったその他の工程は必要ありません。（保護シートの貼り付け、テンション付加、均等割り、UV照射などの工程は要りません。）
- 順次劈開：ワークの右端からピッチ送りをしながら順番に左端まで劈開を行います。
- 短時間に簡単に出来るアライメント機構及び操作。
- 画像処理機能搭載（オプション）  
：カッターとスクライブの位置ズレを自動で補正する事が可能となり、劈開途中の手動によるアライメントが不要となります。
- 糊無しシートの使用により、糊残りの不良はありません。
- 新方式により安定した劈開が可能。
- コストパフォーマンスに優れています。

## 新方式

透明ガラス板の下にワークを貼り付け、下からカッターを上昇させて劈開する方式。また、透明ガラス板の上に、前後するカメラが取り付けられているので、ワークの劈開位置及びカッターの刃先がモニター出来、操作性に優れている。

## 装置の構成

- 本体
- ビデオモニター（12インチモノクロ）
- 光源（50Wハロゲンランプ）
- ティーチングペンダント（左右及び上下動作データ設定器）

# LD劈開装置 ABK-2000

## ■仕様

- ワークサイズ : 50×50mm以内 (チップサイズ例 : 250 $\mu$ m×250 $\mu$ m×80 $\mu$ m)
- ワーク材 : 半導体レーザー等 (注1)
- 劈開時間 : 約0.75秒/サイクル (最小) × 劈開回数  
(1サイクル: 劈開後ピッチ送りし次の劈開動作まで。)
- データ設定器にて速度の変更設定可。
- ピッチ送り量 : 0~50mm (2 $\mu$ mステップ) の範囲で任意に設定可。
- カッター位置 : 上昇、下降、待機位置をストローク範囲内 (8mm) で任意設定可
- カメラ位置 : 前、後位置を、ストローク範囲内 (50mm) で任意設定可

注1 : 最適な劈開条件を出す為、お客様よりワークをお借りする必要があります。

## ■動作軸仕様

- X軸 : ワークの左右      ストローク : 50mm / 分解能 : 2 $\mu$ m
- Y軸 : カメラの前後      ストローク : 50mm / 分解能 : 2 $\mu$ m
- Z軸 : カッターの上下      ストローク : 8mm / 分解能 : 0.25 $\mu$ m

## ■一般仕様

- 供給電源 : 単相AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力 : 800VA
- エアー : 正圧、負圧共不要
- 最大外形寸法 : 600W×700D×835H
- 重量 : 約100Kg

注) 予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

**Actes Kyosan**  
アクテス京三株式会社

〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北 1-8-33  
TEL:046-222-7871 FAX:046-222-7352

販売代理店